仅供内部参考，请勿外传

电子

发布时间：2026-08-30

证券研究报告 / 行业动态报告

英伟达 Q2 超预期，盛科通信单季收入创历史新高

优于大势

上次评级:优于大势

---电子行业周报

报告摘要：

AI 算力：英伟达 Q2 超预期，国产大模型持续迭代。1）英伟达 2027 财年第二季度营收 962 亿美元，同比增长 106%，超出市场预期。2）OpenAI 公布与博通联合开发的自研 AI 芯片 Jalapeno 测试进展。3）智谱发布 GLM-5.3-Flash，在线业务由约 10 万张国产 AI 芯片承载。4）英伟达宣布推理加速器 Groq 3 LPX 机架进入全面量产。5）英伟达与 Apollo、BlackRock 等金融机构合作，计划撬动超 5000 亿美元第三方资本投入 AI 基础设施。6）OpenAI 宣布终止与 Cursor 的合作关系。7)腾讯混元发布并开源 Hy4 preview 大模型。8）盛科通信 2026 年上半年营收 6.71 亿元、同比增长 32.04%，Q2 单季收入 4.22 亿元创历史新高，存货与预付款等先行指标抬升，指向后续营收加速释放。

存储：内存墙问题依旧严峻，长鑫科技中报业绩高增。1）美光表示 AI 加速器算力提升速度快于 HBM 带宽增长，内存墙问题加剧，晶圆消耗、先进封装及散热成为 AI 算力扩张的瓶颈。2）三星电子、SK 海力士计划增加对英伟达 8 层 HBM4 产品供应，8 层产品有望成为下一代 HBM4E 的重要形态。3）大普微获得约 34.91 亿元企业级 PCIe SSD 订单，约占公司 2025 年主营业务收入的 152.70%。4）高通联合三星电子、SK 海力士和台积电推进 HBC 商业化，首代产品计划 2027 年出货。5）SK 海力士美国 HBM 先进封装工厂奠基，计划投资约 40 亿美元。6）长鑫科技上半年营收 1503.1 亿元，同比增长 873.64%，归母净利润 776.05 亿元，同比扭亏。

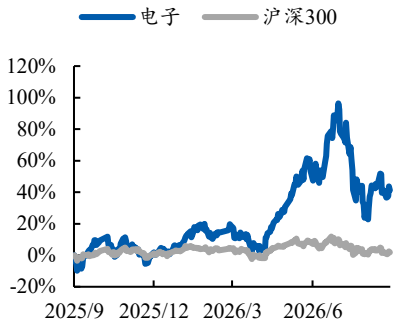
集成电路：小米 3nm 芯片发布，发改委提出推动全链条突破。1）小米公布玄戒 O3 芯片架构，采用 3nm 工艺，集成 240 亿颗晶体管。2）金辰股份拟投资 10 亿元建设半导体装备研发及制造项目。3）立昂微拟投资约 30 亿元建设 12 英寸硅片项目。4）国家统计局数据显示，1-7 月集成电路制造业利润同比增长 18.5 倍。5）信维通信拟以约 11 亿元取得益阳电子科技 55%股权，布局高端 MLCC 业务。6）国家发改委提出推动集成电路全链条突破。

光通信：光模块龙头中报高增，CPO 样品已交付。1）中际旭创上半年营收 417.78 亿元，同比增长 182.49%；新易盛营收 209.10 亿元，同比增长 100.34%。2）拓斯达拟以约 1.47 亿元收购来勒光电 49%股权。3）瑞可达调整募投项目，拟将约 2 亿元投向高速通信连接组件。4）工业富联 CPO 全光交换机样品已向客户交付。5）国家统计局数据显示，1-7 月光纤制造业利润同比增长 468.4%。6）环旭电子与光创联推进超高功率 ELSFP 产品。

下周关注重点：1）产业事件：英伟达 Vera Rubin 平台量产爬坡进展、CPO 全光交换机客户部署反馈；2）宏观数据：关注美国就业与通胀数据对 AI 算力板块的风险偏好的影响；3）政策跟踪：国家发改委集成电路全链条突破相关政策的配套落地；4）海外产业：高通 HBC 首代产品送样验证进展、SK 海力士美国 HBM 工厂建设动态。

风险提示：全球 AI 算力投资不及预期风险；存储芯片价格波动与供给格局变化风险；中美贸易摩擦与出口管制加剧风险。

历史收益率曲线



涨跌幅（%）	1M	3M	12M
绝对收益	5%	-12%	42%
相对收益	5%	-6%	39%

行业数据

成分股数量（只）	518
总市值（亿）	245405.23
流通市值（亿）	164331.10
市盈率（倍）	127.88
市净率（倍）	7.85
成分股总营收（亿）	43693.97
成分股总净利润（亿）	1918.99
成分股资产负债率（%）	48.77

相关报告

《长存 IPO 获受理，加速半导体产业链共振》

--20260824

证券分析师：李玖
执业证书编号：S0550522030001
lijiu1@nesc.cn

证券分析师：武芃睿
执业证书编号：S0550522110001
wupr@nesc.cn

证券分析师：张禹
执业证书编号：S0550524120002
zhangyu2@nesc.cn

仅供内部参考，请勿外传

目 录

1. 本周行情复盘 3
2. 本周行业重点事件 4
2.1 AI 算力：英伟达 Q2 超预期，国产大模型持续迭代。 4
2.2 存储：内存墙问题依旧严峻，长鑫科技中报业绩高增。 4
2.3 集成电路：小米 3nm 芯片发布，发改委提出推动全链条突破。 5
2.4 光通信：光模块龙头中报高增，CPO 样品已交付。 6
3. 风险提示 7

图表目录

图 1：本周申万各行业涨跌幅指数 3
图 2：申万电子细分行业本周涨跌幅情况 3

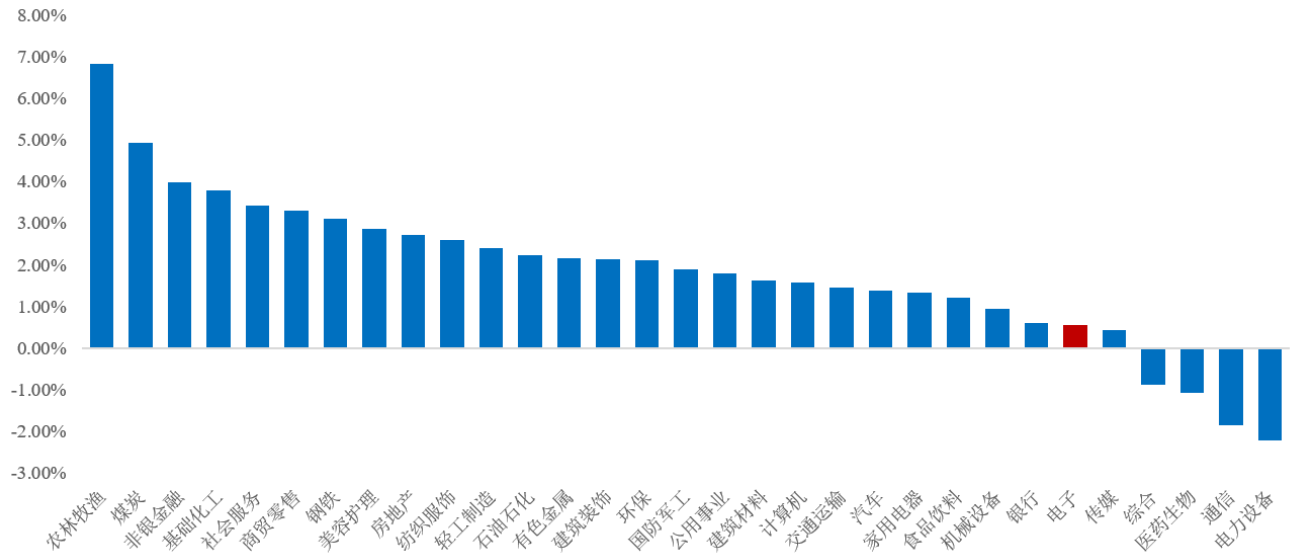
表 1：本周电子个股涨跌幅前五 4

仅供内部参考，请勿外传

1. 本周行情复盘

本周上证指数涨幅 1.20%，深证成指跌幅 1.00%，科创板综指跌幅 0.71%，创业板指跌幅 3.42%。申万电子指数周涨幅 0.56%，在 31 个子行业中排名 26。

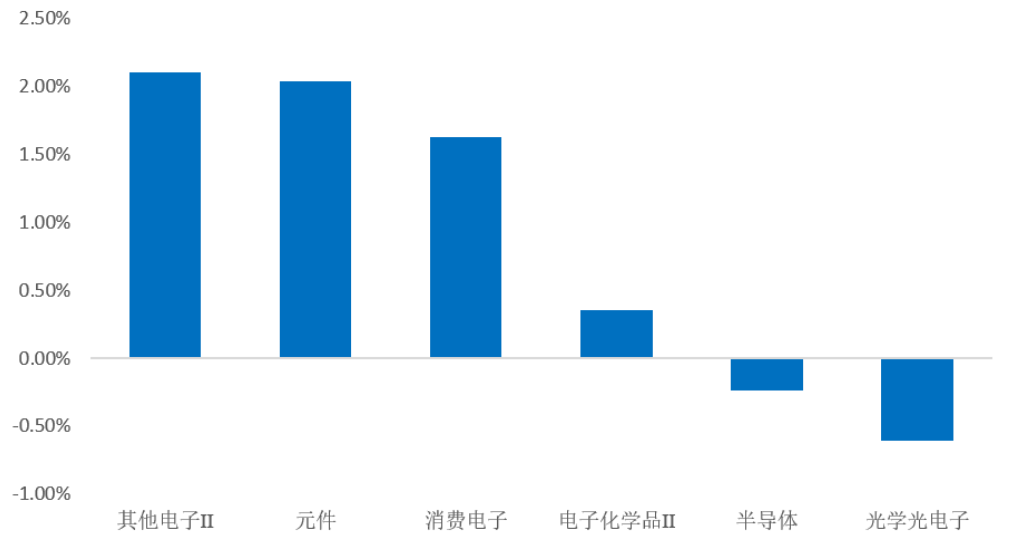
图 1：本周申万各行业涨跌幅指数



数据来源：Choice，东北证券

电子细分板块中表现前三为：其他电子II涨幅 2.10%，元件涨幅 2.03%，消费电子涨幅 1.63%。

图 2：申万电子细分行业本周涨跌幅情况



数据来源：Choice，东北证券

个股涨幅前三为捷荣技术（45.82%）、英集芯（35.01%）、超频三（32.74%）。个股跌幅前三为普冉股份（-16.48%）、戈碧迦（-15.48%）、世华科技（-13.74%）。

仅供内部参考，请勿外传

表 1：本周电子个股涨跌幅前五

	证券代码	证券名称	涨跌幅	股价（元）	公司市值（亿元）
涨幅前五	002855.SZ	捷荣技术	45.82%	14.64	36.08
	688209.SH	英集芯	35.01%	29.54	128.14
	300647.SZ	超频三	32.74%	7.5	34.30
	300456.SZ	赛微电子	28.05%	40.4	295.81
	688183.SH	生益电子	25.67%	131.2	1098.92
跌幅前五	688766.SH	普冉股份	-16.48%	401.18	596.57
	920438.BJ	戈碧迦	-15.48%	104.8	151.40
	688093.SH	世华科技	-13.74%	21.85	61.26
	603068.SH	博通集成	-13.67%	35.74	54.25
	920161.BJ	龙辰科技	-12.84%	23.56	32.04

数据来源：Chocie，东北证券

2. 本周行业重点事件

2.1 AI 算力：英伟达 Q2 超预期，国产大模型持续迭代。

英伟达 2027 财年第二季度业绩超预期。8 月 27 日，英伟达公布 2027 财年第二季度财报（截至 2026 年 7 月 26 日）。单季营收 962.21 亿美元，同比增长 106%，环比增长 18%；数据中心收入 890 亿美元，同比增长 117%；净利润 596.88 亿美元，同比增长 126%；GAAP 毛利率 75%。英伟达预计 2027 财年第三季度营收 1080 亿美元，上下浮动 2%。公司同时表示 Vera Rubin 平台已进入全面量产，并推出了面向 AI 智能体的首款 CPU 产品 Vera。

英伟达推理加速器 Groq 3 LPX 机架进入全面量产。8 月 25 日，英伟达宣布推理加速器 Groq 3 LPX 机架已进入全面量产阶段，Groq 机架将与 Vera 中央处理器和 Rubin 图形处理器一同部署在新型云服务商 Nebius 的数据中心。

OpenAI 公布自研 AI 芯片 Jalapeno 测试进展。8 月 26 日，OpenAI 公布与博通联合开发的自研 AI 芯片 Jalapeno 测试进展，公司称其在单位功耗 AI 处理量及响应速度方面表现突出，计划年内用于自有 AI 基础设施。

智谱发布 GLM-5.3-Flash，在线业务由约 10 万张国产 AI 芯片承载。8 月 27 日，智谱发布 GLM-5.3-Flash，其在线业务由约 10 万张国产 AI 芯片承载，成为国产 AI 算力大规模承载真实模型调用的案例。

英伟达联合金融机构撬动超 5000 亿美元第三方资本。8 月 27 日，英伟达宣布与 Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、高盛及 KKR 等金融机构合作，计划逐步撬动超过 5000 亿美元第三方资本投入 AI 基础设施建设。

OpenAI 宣布终止与 Cursor 的合作关系。OpenAI 发布声明，宣布终止与 Cursor 的合作关系，表示 Cursor 被 SpaceX 收购后，已经不被 OpenAI 信任。

腾讯混元发布并开源 Hy4 preview 大模型。8 月 28 日，腾讯混元发布并开源新一代大语言模型 Hy4 preview，总参数 770B、激活参数 49B，上下文长度超 1M。

2.2 存储：内存墙问题依旧严峻，长鑫科技中报业绩高增。

美光称内存墙问题进一步加剧。8 月 24 日，美光表示 AI 加速器算力提升速度明显快于 HBM 带宽增长，内存墙问题进一步加剧，晶圆消耗、先进封装及散热正成为 AI 算力扩张的重要瓶颈。美光的判断反映出，在 AI 训练与推理算力持续升级的背

仅供内部参考，请勿外传

景下，存储带宽的供给增速落后于算力增速，制约因素正从单纯的存储容量向晶圆、封装与散热等环节扩散。

三星电子、SK 海力士计划增加对英伟达 8 层 HBM4 产品供应。8 月 26 日，据韩媒报道，三星电子与 SK 海力士计划增加对英伟达 8 层 HBM4 产品的供应，以保障不同规格 HBM 供给的稳定，并改善散热表现。8 层产品有望成为下一代 HBM4E 的重要产品形态。

大普微获约 34.91 亿元企业级 PCIe SSD 订单。8 月 26 日，大普微获得约 34.91 亿元企业级 PCIe SSD 订单，订单金额约占公司 2025 年主营业务收入的 152.70%。该订单反映 AI 数据中心企业级存储需求的持续增长。

高通联合三星电子、SK 海力士和台积电推进 HBC 商业化。8 月 27 日，据韩媒报道，三星电子、SK 海力士正与高通合作推进高带宽计算（HBC）芯片的商业化。高通负责制造 DRAM 芯片下方的计算芯片并提供 TSV 设计，三星电子和 SK 海力士负责 DRAM 芯片堆叠，台积电负责各项技术与封装工艺的整合。第一代 HBC 产品计划于 2027 年实现商业化并出货，将集成到高通 AI 加速器 AI250 中。HBC 将多颗低功耗 DRAM（LPDDR）芯片垂直堆叠并置于加速芯片上方，与 HBM 类似采用硅通孔（TSV）工艺实现 3D 堆叠。

SK 海力士美国 HBM 先进封装工厂奠基。8 月 28 日，SK 海力士美国 HBM 先进封装工厂奠基，公司计划投资约 40 亿美元建设印第安纳州工厂，首座洁净室预计 2028 年启用。SK 海力士判断全球存储芯片短缺可能持续至 2030 年底。

长鑫科技上半年营收增长逾 8 倍，归母净利润扭亏为盈。8 月 28 日，长鑫科技（688825）发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 1503.1 亿元，同比增长 873.64%；归母净利润 776.05 亿元，上年同期为亏损 23.32 亿元，同比扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额 1311.56 亿元，同比增长 2985.64%。分季度看，第二季度营收 995.1 亿元，环比增长 95.9%，归母净利润 528.43 亿元，环比增长 113.4%，上半年主营业务毛利率达 84.84%。据 Counterpoint Research 数据，按 2026 年一季度收入计，长鑫科技全球 DRAM 市场份额约 8%，位列全球第四。公司披露 LPDDR6 产品最高速率 12800Mbps、芯片容量 16GB，已向关键客户送样验证，并正加速推进量产。

2.3 集成电路：小米 3nm 芯片发布，发改委提出推动全链条突破。

小米公布玄戒 O3 芯片架构。8 月 24 日，小米公布玄戒 O3 芯片架构，该芯片采用 3nm 工艺，集成 240 亿颗晶体管，搭载 10 核 CPU 和 16 核 GPU，CPU、GPU 性能较上一代分别提升 60%和 85%。

金辰股份拟投资 10 亿元建设半导体装备研发及制造项目。8 月 25 日，金辰股份披露拟投资 10 亿元建设半导体装备研发及制造项目，公司业务由此前以光伏设备为主，进一步向泛半导体装备领域延伸。

立昂微拟投资约 30 亿元建设 12 英寸硅片项目。8 月 26 日，立昂微披露拟投资约 30 亿元建设 12 英寸硅片项目，规划月产 20 万片 12 英寸轻掺衬底片和 12 万片硅外延片，全面达产后预计年产值超过 13 亿元。

1-7 月集成电路制造业利润同比增长 18.5 倍。8 月 27 日，国家统计局数据显示，1-7 月集成电路制造业利润同比增长 18.5 倍，电子工业利润同比增长 1.1 倍，集成电路成为电子行业利润增长的重要驱动。

仅供内部参考，请勿外传

信维通信拟收购益阳电子科技 55%股权。8 月 27 日，信维通信披露拟以约 11 亿元现金取得益阳电子科技 55%股权，交易完成后合计持股 70%，进一步布局高端 MLCC 及电子元器件业务。

国家发改委提出推动集成电路全链条突破。8 月 28 日，国家发改委提出推动集成电路全链条突破，将围绕高端设计、先进制造、功率及化合物半导体、先进封装和存储等领域推进关键核心技术攻关。

盛科通信 2026 年上半年营收同比增长 32.04%，Q2 单季收入创历史新高。8 月 26 日，盛科通信发布 2026 年半年度报告，上半年实现营业收入 6.71 亿元，同比增长 32.04%；归母净利润亏损 0.18 亿元，同比减亏 25.85%。其中二季度实现收入 4.22 亿元，环比增长 69.98%，创单季历史新高。上半年研发费用 2.61 亿元，占营业收入的 38.99%。财务先行指标方面，二季度末存货 5.52 亿元、环比增长 66%，应收账款 2.3 亿元、环比增长 74%，预付款 2.99 亿元维持较高水平，购买商品、接受劳务支付的现金 4.29 亿元、环比提升约 90%。此外，公司 7 月将向中国电子及其下属公司的年度销售预计额度由 6 亿元提高至 22 亿元，8 月公告与中电港签订以太网交换芯片长期销售合同、金额超过 2025 年营业收入的 50%，上述订单尚未计入上半年报表。盛科通信作为国内以太网交换芯片领先企业，其采购现金流、存货到营收的传导链条显示，Q2 库存与采购现金流的抬升指向后续营收的加速释放，叠加 7-8 月集中落地的大额销售框架与长期合同，公司下半年收入有望进入加速兑现期，国产交换芯片在 AI 数据中心组网中的渗透率提升逻辑延续。

2.4 光通信：光模块龙头中报高增，CPO 样品已交付。

中际旭创上半年营收增长 182.49%。8 月 24 日，中际旭创披露 2026 年半年度报告，上半年实现营收 417.78 亿元，同比增长 182.49%；归母净利润 136.51 亿元，同比增长 241.7%。营收与利润的高速增长反映 AI 数据中心对高速光模块需求的强劲，1.6T 等高速产品的放量推动龙头厂商规模效应进一步显现，光模块环节的行业集中度持续提升。

新易盛上半年营收增长 100.34%。8 月 24 日，新易盛披露 2026 年半年度报告，上半年实现营收 209.10 亿元，同比增长 100.34%；归母净利润 75.29 亿元，同比增长 90.98%。其中光互联产品营收 208.83 亿元，毛利率 48.46%。营收高增与毛利率提升反映高速率光模块产品销售占比的提升与产品结构的优化，AI 算力投资向光模块环节的传导仍在持续。

拓斯达拟收购来勒光电 49%股权。8 月 24 日，拓斯达披露拟以约 1.47 亿元收购来勒光电 49%股权。来勒光电主要生产光模块高精度耦合及自动化设备，拓斯达借此进一步切入高速光通信设备产业链。此举反映自动化设备厂商向光模块设备环节延伸，光模块及硅光、CPO 扩产带动上游高精度耦合与自动化设备需求，设备环节的国产化空间进一步打开。

瑞可达调整募投项目投向高速通信连接组件。8 月 24 日，瑞可达披露调整募投项目，拟将约 2 亿元募集资金投向高速通信连接组件及无源光连接产品，进一步覆盖数据中心和 AI 服务器高速互连需求。此举反映连接器厂商向高速通信连接环节延伸，AI 服务器高速互连对连接组件的需求持续增长，推动相关厂商完善产品布局。

工业富联 CPO 全光交换机样品交付。8 月 26 日，工业富联表示 CPO 全光交换机样品已向客户完成交付，同时 ASIC AI 服务器机柜出货增长，公司持续强化 AI 服务器与高速光互连布局。此举反映 CPO 从概念验证走向工程化落地，全光交换机样品的交付表明 CPO 商业化进程推进，光互连技术路线正加速向共封装光学方向演进。

仅供内部参考，请勿外传

1-7 月光纤制造业利润同比增长 468.4%。8 月 27 日，国家统计局数据显示，1-7 月光纤制造业利润同比增长 468.4%，光缆制造业利润增长 62.6%，通信系统设备制造业利润增长 55%。光纤制造业利润的大幅增长反映 AI 算力网络建设对光纤光缆的需求拉动，光通信产业链整体盈利水平同步提升，上游光纤环节的景气度领先于中下游。

环旭电子与光创联推进超高功率 ELSFP 产品。8 月 28 日，环旭电子与光创联推进超高功率 ELSFP 产品，该产品面向 NPO、CPO 外置激光源应用，目前已完成样品开发并推进小批量验证，预计 2027 年一季度进入量产。此举反映 CPO 产业链配套环节的推进，外置激光源（ELSFP）作为 CPO/NPO 方案的关键配套，其样品开发与小批量验证的推进意味着 CPO 供应链正在逐步完善。

2.5 下周关注重点

1）产业事件：英伟达 Vera Rubin 平台量产爬坡进展、CPO 全光交换机客户部署反馈；2）宏观数据：关注美国就业与通胀数据对 AI 算力板块的风险偏好的影响；3）政策跟踪：国家发改委集成电路全链条突破相关政策的配套落地；4）海外产业：高通 HBC 首代产品送样验证进展、SK 海力士美国 HBM 工厂建设动态。

3. 风险提示

- 全球 AI 算力投资不及预期风险；
- 存储芯片价格波动与供给格局变化风险；
- 中美贸易摩擦与出口管制加剧风险。

仅供内部参考，请勿外传

研究团队简介：

李玖：北京大学光学博士，北京大学国家发展研究院经济学学士（双学位），电子科技大学本科，曾任华为海思高级工程师、光峰科技博士后研究员，具有三年产业经验，2019 年加入东北证券，现任电子行业首席分析师。

武芃睿：英国南安普顿大学光电研究中心硕士，华中科技大学光电信息本科，武汉大学工商管理学士（双学位）。曾任华为和上海微电子光电工程师，具有三年产业经验，2020 年加入东北证券，现任电子团队全球科技负责人。

张禹：复旦大学物理电子学博士，复旦大学电气工程及其自动化本科。2022 年加入东北证券，现任电子行业联席首席分析师。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票投资评级说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业投资评级说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

仅供内部参考，请勿外传

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：http://www.nesc.cn 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630